

半導體工程系 碩士班 115 學年度入學課程結構規劃表

課程類別			一年級						二年級									
			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期						
			課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數				
學院共同課程 (由學院開課)		選修	開關變換器的基本設計與分析微學分/1/1 機器人競賽與挑戰微學分/1/1 網路與排隊理論/3/3 微波工程與應用/3/3 低碳能源產業與技術微學分/1/1 再生能源導論微學分/1/1															
學院跨領域課程 (由學院開課)		選修	區塊鏈技術與應用/3/3 區塊鏈智能合約實務/3/3															
專業課程	必修	應修課程數 4 門/ 應修學分數 15 學分	微電子工程科技		3	3	專題研究(二)		3	3	論文		6	6	論文		6	6
			專題研究(一)		3	3												
	選修	應修學分數 至少 19 學分	奈米材料/3/3 高等微機電製程/3/3 電源系統設計/3/3 高等半導體元件/3/3 發光二極體專論/3/3 高等積體電路製程/3/3 水下高等訊號處理/3/3 FPGA 設計與應用/3/3 高等類比積體電路設計/3/3 微波單晶積體電路設計(一)/3/3 高等發光二極體製造技術及應用/3/3 感測應用與自動化生產/3/3 高等電源管理晶片設計與實習/3/3 VLSI 元件物理/3/3 半導體元件設計與模擬/3/3 光電工程/3/3 水下通訊/3/3 太陽能工程/3/3 高等 MEMS 設計/3/3 半導體感測元件/3/3 數位積體電路設計/3/3 系統晶片應用實務/3/3 光電元件量測與分析/3/3 混合式訊號積體電路設計/3/3 微波單晶積體電路設計(二)/3/3 可程式邏輯控制與生產自動化系統設計/3/3 射頻與微波電路設計/3/3 學期實習-產業實習(一)/3/3 VLSI 元件物理/3/3 半導體元件設計與模擬/3/3 寬能隙半導體專論/3/3 學期實習-產業實習(二)/3/3															

備註：

- 一、畢業總學分數為 34 學分。
- 二、必修 15 學分，選修 19 學分。
- 三、學生修讀所屬學院之「學院共同課程」應認列為本系專業課程學分；修讀所屬學院之「學院跨領域課程」或其他學院開課之課程，則認列為外系課程學分。
- 四、系所訂定條件（學程、檢定、證照、承認外系學分及其他）：
 1. 論文，請擇一學期修讀，修畢且及格者方可畢業。
 2. 承認外系選修學分 6 學分為專業選修(外籍生修習外系課程需經指導教授同意，不受 6 學分限制)。
 3. 規定需修習至少一門英文授課(本系相關領域專業課程)，其學分承認包含在畢業學分數內。

